

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于增加2026年度公司及全资子公司向金融机构 申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议及第四届董事会审计委员会第十一次会议，上述会议审议并通过了《关于增加2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增加前综合授信情况

公司分别于2026年4月10日召开第四届董事会第十二次会议、2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》。同意公司及子公司向各金融机构（包含但不限于商业银行）申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司2026年4月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

二、本次增加后综合授信情况

根据公司战略布局、结合财务状况及经营业务的需求，公司2026年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商业银行）增加总额人民币100,000万元的综合授信额度，2026年总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度，上述综合授信期限为2026年第二次临时股东会批准日起至2026年年度股东会召开日止。

上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型

包括但不限于抵押、质押、保证等。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际发生的融资金额，具体融资金额视公司及相关子公司的实际需求确定及分配，并在上述额度内以银行实际审批情况为准。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

上述申请授信额度事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026年8月10日